

# 機器利用技術講習会のご案内

## 【触針式膜厚測定装置】

地方独立法人大阪府立産業技術総合研究所では、所有している試験研究機器等を用いて、中小企業の皆様の新技術・新製品の開発や生産管理・品質管理をお手伝いさせて頂いております。これら試験研究機器の利用範囲や仕様・性能などの特徴を、より具体的にご理解いただき、皆様方に一層ご利用頂くため、下記の要領で講習会を開催しますのでご案内申し上げます。

◆日 時：平成26年11月5日(水) 14:15～15:30

※当日、「半導体デバイス製造用スパッタ装置(10:15～14:00)」および「ホール効果測定装置(15:45～17:00)」の機器利用技術講習会も行っております。当講習会では、これらの機器利用技術講習会で作製した薄膜試料の膜厚を測定します。そして、膜厚測定を行った試料に対して電気特性評価のためのホール効果測定も行います。装置の理解をより深めるためにも「半導体デバイス製造用スパッタ装置」および「ホール効果測定装置」の機器利用技術講習会を当講習会とあわせて受講されることを強く推奨いたします。

◆場 所：(地独) 大阪府立産業技術総合研究所(和泉市あゆみ野2-7-1 TEL:0725-51-2518)  
当日は、講習開始時刻までに当研究所の玄関ホール 講習会受付にて、受付をお済ませください。担当者が講習会場にご案内します。

◆定 員：3名(1社1名まで)

※ 受講票は発行いたしません。返信で受付をお知らせします。

※ 受講には TRI カード が必要です。まだお持ちでない方は、申し込み方法をご連絡いたします。

◆費 用：無料

◆申込み先：(地独) 大阪府立産業技術総合研究所 顧客サービス室 顧客サービス課

※ お申し込みはメール ([fukyu@tri-osaka.jp](mailto:fukyu@tri-osaka.jp)) またはFAX (0725-51-2509) までお願いします。なお、メールでお申し込みを頂いた方には、当研究所の関連情報をご案内する「産技研ダイレクトメールニュース」を配信させていただきますので、ご了承下さい。

◆対象機器：触針式膜厚測定装置

本装置は、触針(先端半径;2 $\mu$ m、先端角;60°)を試料表面に直接接触させ、サンプルステージを走査することで試料表面の凹凸を測定する装置です。

本装置は、走査中に試料にかかる触針の針圧を低加重(最小0.05mgf)に設定できるため、金属膜や無機膜だけでなくレジスト膜や高分子樹脂のような柔らかい表面の凹凸測定が可能となります。また、走査中に針圧が変動しないため、高精度で信頼性のあるデータを得ることができます。

本講習会は、初めて蒸着薄膜膜厚測定を行う方を対象に、機器の概要説明を行なった後、装置付属の標準試料等を用いて、試料のセットアップ方法および測定の実演を行います。



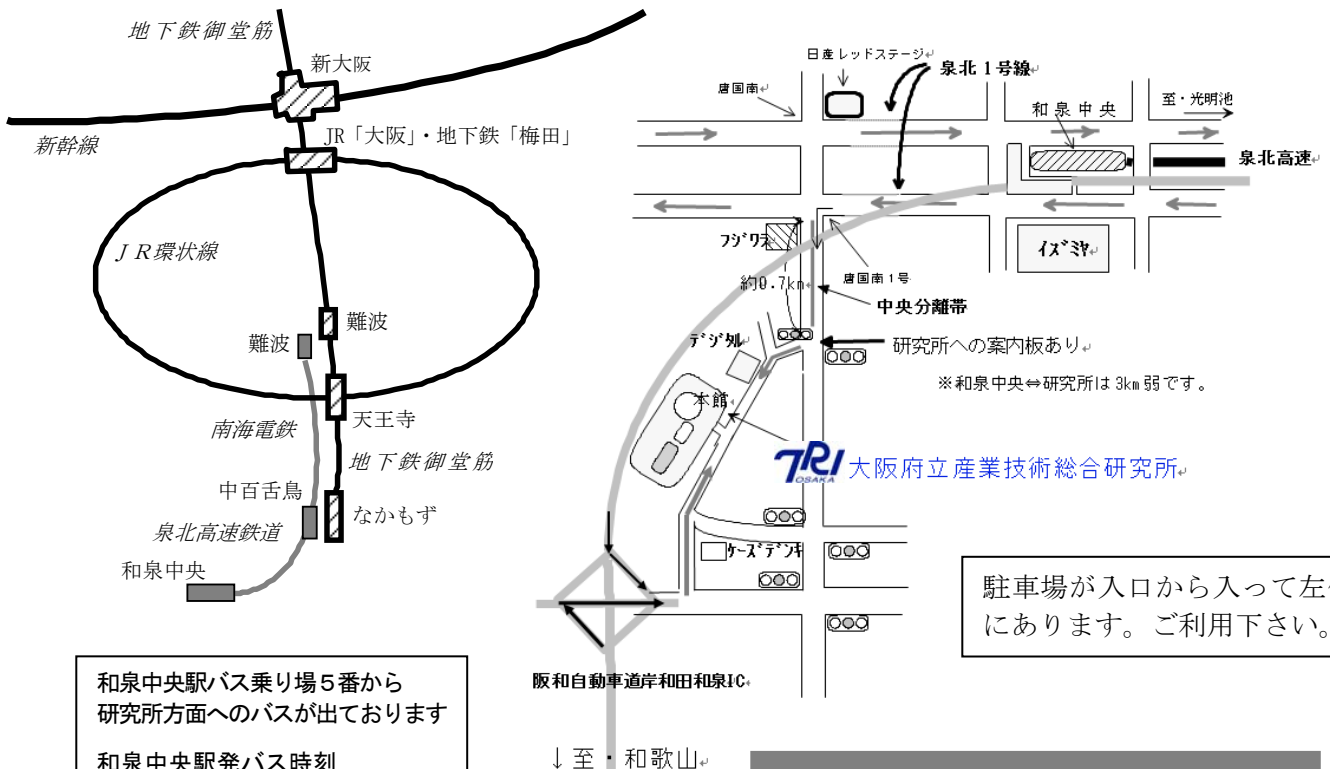
機器型番：P-16+  
KLA-Tenchor 株式会社

◆講習担当：(地独) 大阪府立産業技術総合研究所

制御・電子材料科 山田 義春、笈 芳治、近藤 裕佑

・お問い合わせ先：顧客サービス課 (TEL：0725-51-2518)

大阪府立産業技術総合研究所交通案内図(略図)



和泉中央駅バス乗り場5番から  
研究所方面へのバスが出ております

和泉中央駅発バス時刻  
9時: 0, 15, 30分  
10時~15時: 毎0, 30分

**FAX 0725-51-2509**

機器利用技術講習会申込書 テーマ「触針式膜厚測定装置」

開催日：平成26年11月5日(水)

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 企業名     |                                                        |
| 所在地     | (〒 )                                                   |
| 参加者     | 所属： 役職： 氏名：<br><br>TRIカードをお持ちの方は、「K番号」のご記入をお願いします。(K ) |
| 連絡先     | TEL： FAX：                                              |
| 講習会の情報源 | ①産技HP ②産技メール配信 ③産技チラシ ④他機関の情報 ⑤その他( )                  |

講習会の案内など、当研究所の関連情報をお知らせする「産技研ダイレクトメールニュース」の配信をご希望の方は、下記にメールアドレスをご記入下さい。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

※上記参加申込書に記載された内容につきましては、本講習会の参加者の集計及び下記の目的に使用させていただきます。  
 ①お客様からの問い合わせへの対応、当研究所利用に関する手続きの案内など、お客様サポート。  
 ②当研究所および関連団体の催事情報提供などの案内